

ATM-3100

全自動ウェーハ表面保護テープ貼り機

Fully Automatic Wafer BG Tape Lamination Machine

【概要 - Outline -】

- ◆本装置は、ウェーハ裏面研磨工程のウェーハ表面に保護テープを全自動で貼る装置です。
This machine is to laminate BG tape on wafer in wafer back-grinding process.

【特長 - Features -】

- ◆貼り付けローラー、テーブルに加熱機構付 (オプション)
Laminate tape with heater roller and heater table (option)
- ◆あらゆるテープに最適の条件設定を見出せます。
Optimal lamination condition can be set to various tape kind.
- ◆テープテンションコントロール機構によりノーテンションからの貼付けが可能。
Tape tension controlling system allows free-tension lamination.
- ◆8-12 インチ対応
Applicable to 8 and 12 inch wafer
- ◆FOUP オープナー対応 (オプション)
FOUP opener (option)



項目 Spec	ATM-3100	
対応ウェーハサイズ Wafer Size	8 inch, 12 inch	
使用テープ幅 Tape width	8 inch : 230mm, 12 inch : 330mm	
ユーティリティ	電源 Power	AC100V、単相 (single-phase) 50/60Hz、3.0KVA
	空気源 air	0.4Mpa、100N/min
	真空源 Vacuum source	-74kpa
装置寸法 Dimension	W1,350×D1,650×H2,020	
重量 Weight	600kg	

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.